

| 版数 VER. | 年月日 DATE | CN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|------------|-------------|--------|--|-----------|------------|-------------|-------------|
| 2 | 01/JUL/2011 | 072303 | CHANGED APPLICABLE F.P.C DIMENSION | | K. ASHIBU | T. NEMOTO | M. KIKUCHI |
| 3 | 26/JUL/2011 | 072484 | CHANGED CONNECTOR SHAPE | | K. ASHIBU | T. NEMOTO | Y. YAHIRO |
| 4 | 09/NOV/2011 | 000660 | CHANGED CONNECTOR SHAPE AND APPLICABLE F.P.C DIMENSION | | K. ASHIBU | T. NEMOTO | M. KIKUCHI |
| 5 | 24/AUG/2012 | 003427 | CHANGED CONNECTOR SHAPE AND APPLICABLE F.P.C AND P.C.B DIMENSION | | K. ASHIBU | T. NEMOTO | M. KIKUCHI |
| 6 | 07/DEC/2012 | 004596 | ADDED NEW ITEMS etc | | K. ASHIBU | T. NEMOTO | M. KIKUCHI |
| 7 | 18/DEC/2012 | 004807 | CORRECTED TABLE 2. etc | | K. ASHIBU | T. NEMOTO | M. KIKUCHI |

TABLE 2. DIMENSIONS

| PRODUCT NO. | A | B | C | D | E | F |
|-------------|-----|-----|------|------|-----|------|
| FA1004SA1 | 3.5 | 1.5 | 2.97 | 1.85 | 0.5 | 1.18 |
| FA1005SA1 | 4.0 | 2.0 | 3.47 | 2.35 | 1.0 | 1.68 |
| FA1006SA1 | 4.5 | 2.5 | 3.97 | 2.85 | 1.5 | 2.18 |
| FA1010SA1 | 6.5 | 4.5 | 5.97 | 4.85 | 3.5 | 4.18 |

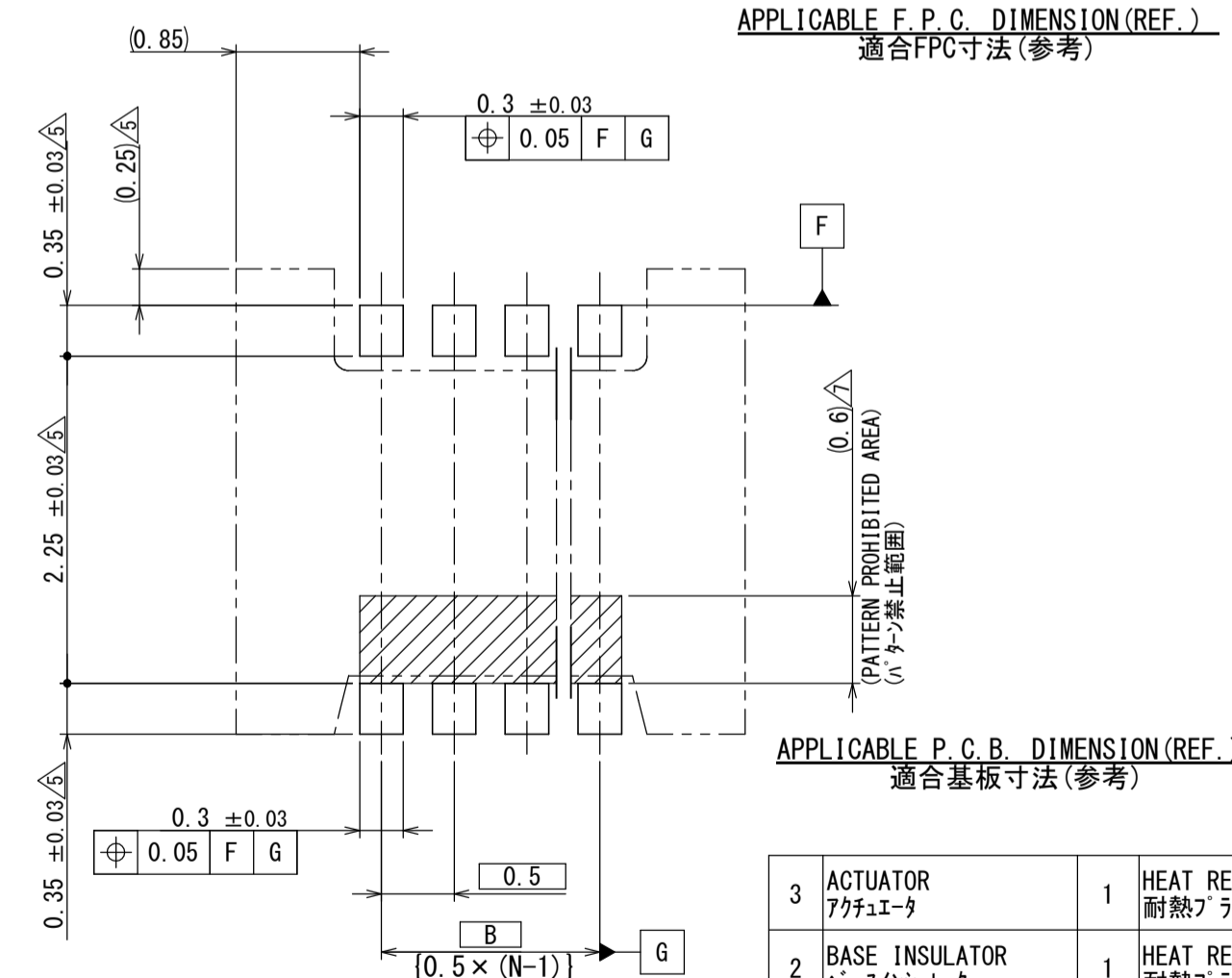
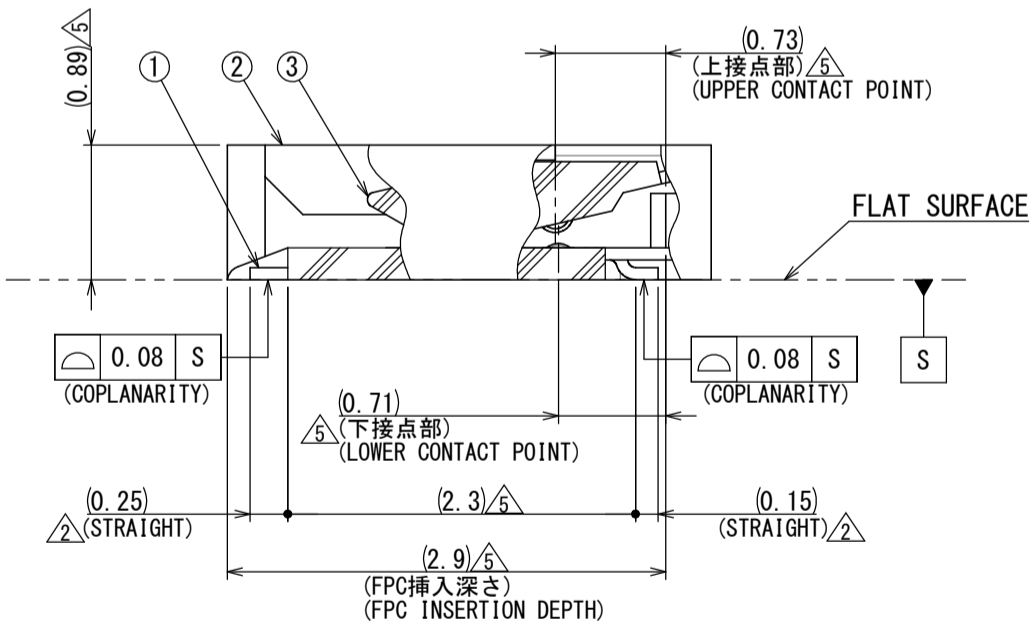
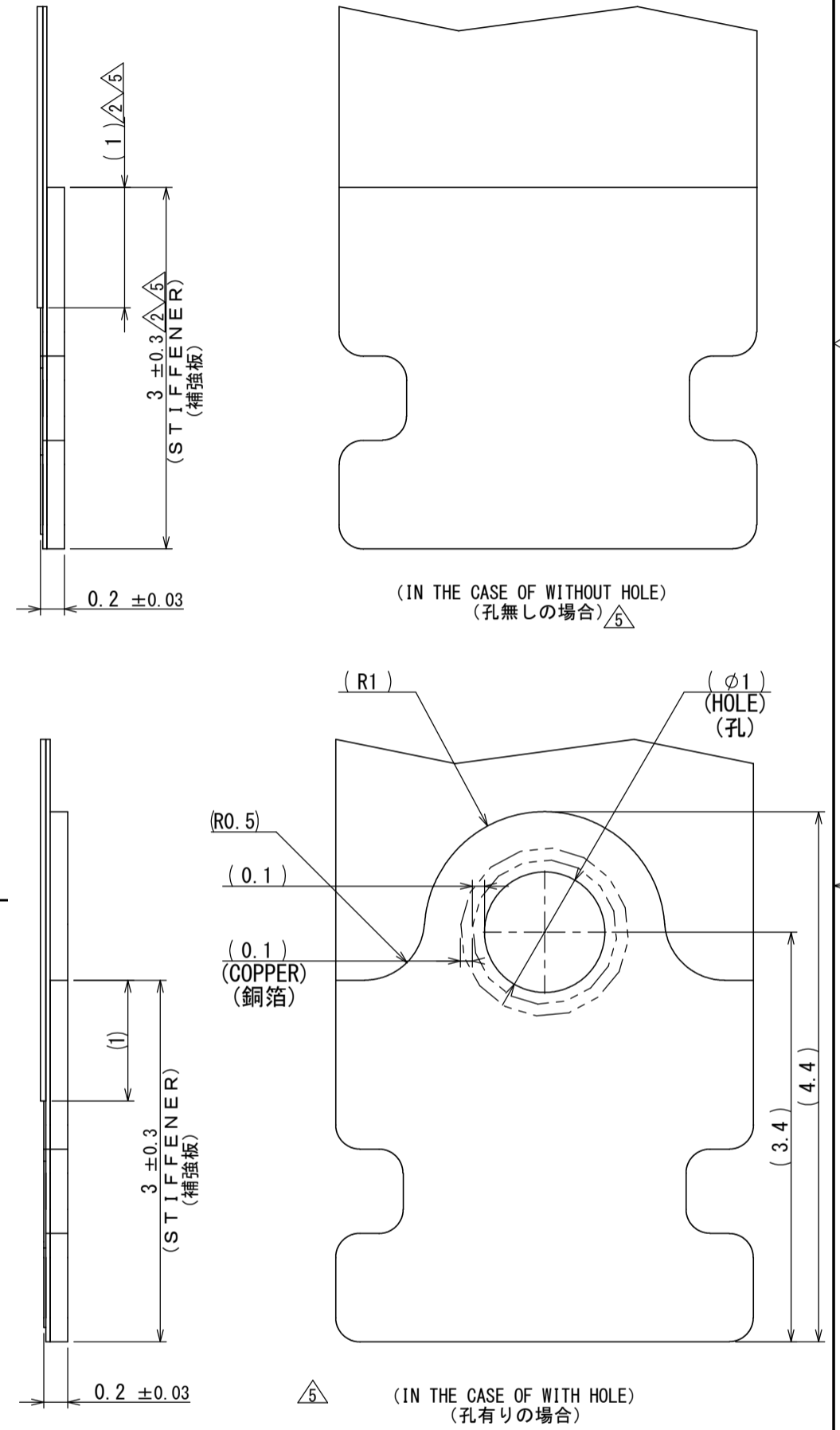
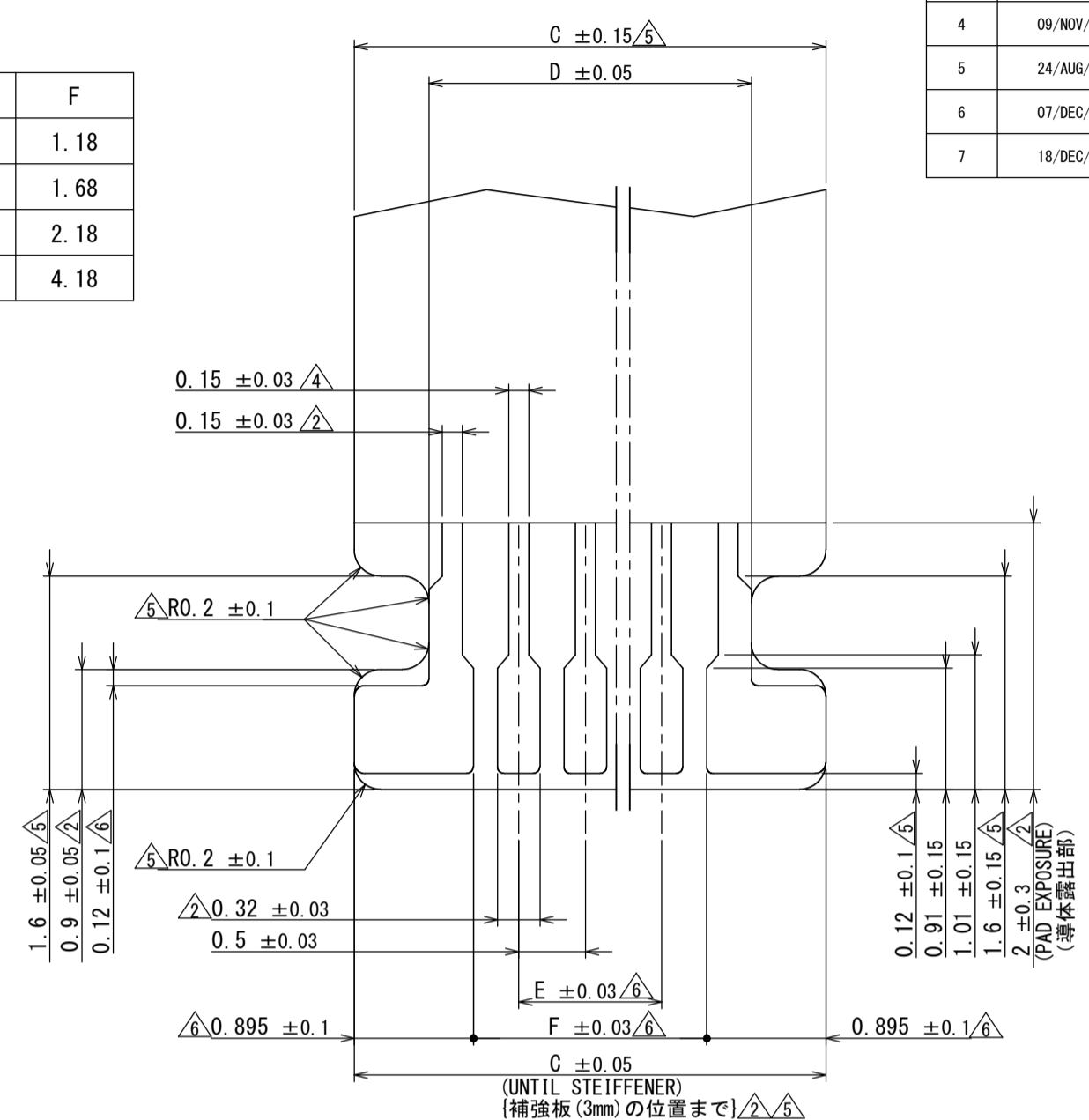
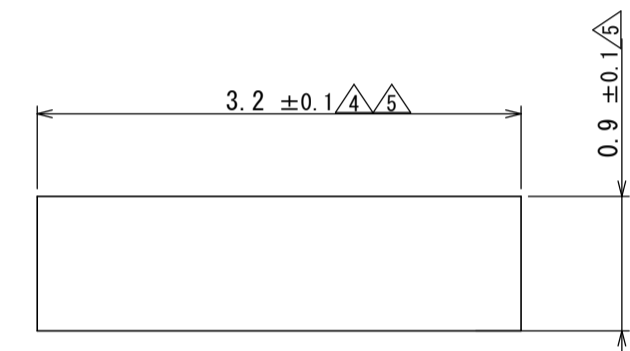
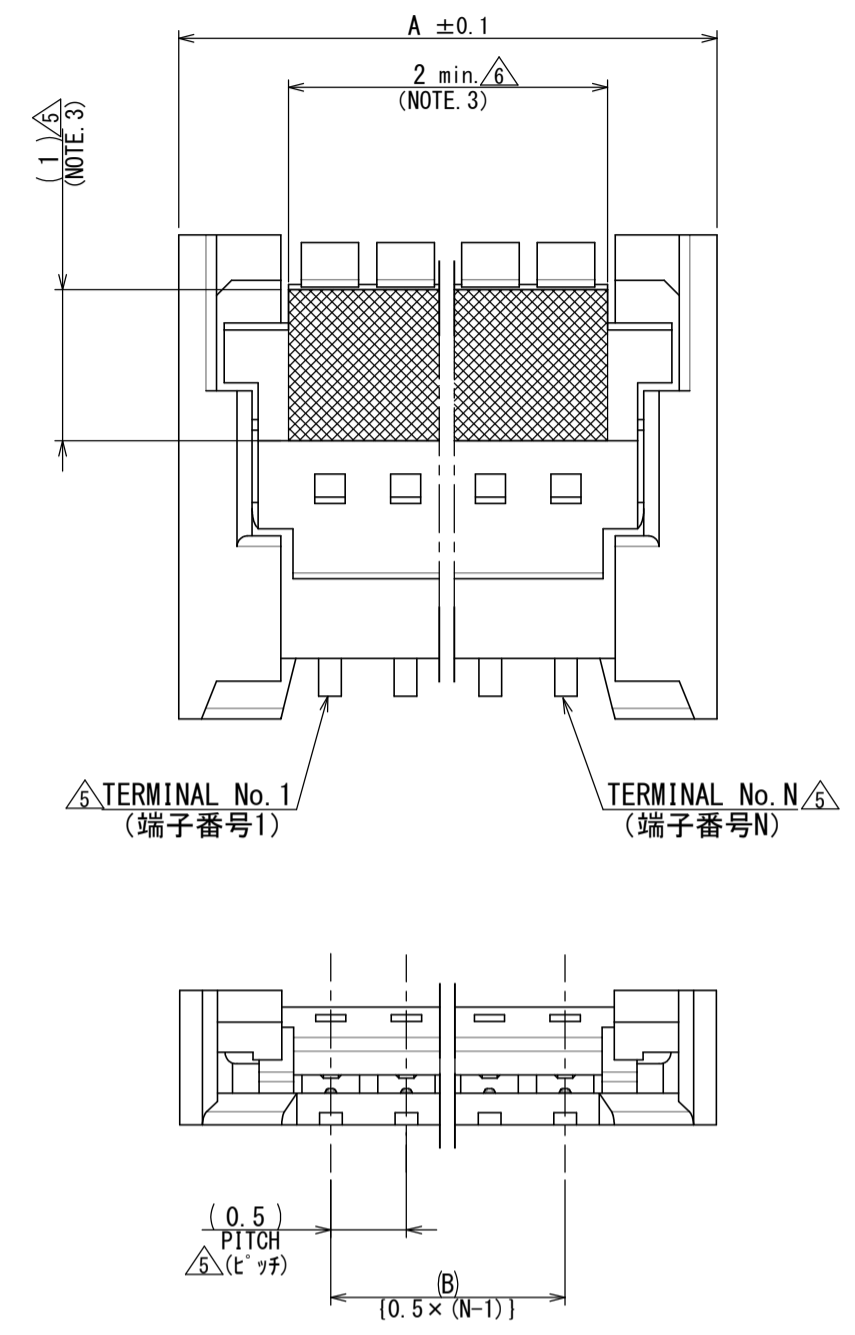


TABLE 1. RECOMMENDED F.P.C. COMPOSITION

| COMPOSITION 層名 | RECOMMENDED 推奨 |
|------------------------|--|
| GOLD PLATING 金めっき | ELECTROLYSIS PLATING 電解めっき 0.1 μm MIN. |
| COPPER 銅箔 | ROLLED MATERIAL 圧延銅 18 μm MAX. |
| ADHESIVE 接着剤 | THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性 - |
| BASE FILM ベースフィルム | POLYIMIDE ポリイミド 25 μm |
| ADHESIVE 接着剤 | THERMOSETTING ADHESIVE 熱硬化性 30 μm MAX. |
| REINFORCE PLATE 補強板 | POLYIMIDE ポリイミド - |

- NOTE
- REFER TO TABLE 1 FOR RECOMMENDED FPC COMPOSITION.
 - A NICKEL BARRIER EXISTS BETWEEN CONTACT POINT AND TAIL.
 - THE DIMENSIONS OF VACUUMING COVER AREA.
 - RECOMMENDED F.P.C. PUNCHER DIRECTION ARE FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER FILM SIDE.
 - CAVITY AND LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP PORTION OF THE CONNECTOR.
 - THIS PRODUCT IS HALOGEN-FREE
- 注記
- 推奨FPC構成はTABLE1参照のこと。
 - コンタクト接点とSMT部の間にはニッケルバリアがあります。
 - 吸着エリアを示す。
 - FPC抜き方向は、導体側から補強板側を推奨します。
 - キャビティおよびロット番号がコネクタ上面に表記されます。
 - 本製品はハロゲンフリー品です。

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| 3 | ACTUATOR アクチュエータ | 1 | HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック | | COLOR : BLACK/色相 : 黒色 UL94V-0 |
| 2 | BASE INSULATOR ベースインシュレータ | 1 | HEAT RESISTING PLASTICS 耐熱プラスチック | | COLOR : BLACK/色相 : 黒色 UL94V-0 |
| 1 | CONTACT コンタクト | N | COPPER ALLOY 銅合金 | PARTIAL GOLD (0.1 μm MIN.) OVER NICKEL ニッケル上部分Au 0.1 μm以上 | |

仕様書(SPECIFICATION)
JACS-10931-*(\triangle)(\triangle)(\triangle)
JAHL-10931 (\triangle)(\triangle)(\triangle)

第1版(ORIGINAL DATE)
01/APR/2011

尺度(SCALE)
1:5

シリアル(SERIES)
FA10

製図
DR. 担当
CHK. K. ASHIBU

査閲
APPD. -

承認
APPD. M. KIKUCHI

名称(TITLE)
FA10**SA1

図面番号(DRAWING NO.)
SJ11450

質量(MASS)

単位(UNIT) : mm

JAE-CONNECTOR.COM
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.)
SJ11450

版数(VER.)
7